

2020年11月27日

DIC株式会社

〒103-8233 東京都中央区日本橋3-7-20
ディーアイシービル

貼れる、はがせる、無線センサー「ハットトッテ™」を第5回スマートビルディング EXPO に出展
— 屋内・屋外環境の温度・湿度・照度をセンシングする IoT 環境センサー —

D I C株式会社（本社：東京都中央区、社長執行役員：猪野薫）は、商業施設やオフィスビルなどの屋内環境や工事現場など屋外環境における温度・湿度・照度のセンシングに用いる、やわらかい無線センサー「ハットトッテ™」（2021年1月～3月期販売開始予定）を、第5回 スマートビルディング EXPO に出展します。

<第5回スマートビルディング EXPO 出展概要>

開催日時：2020年12月2日（水）～4日（金）

開催場所：東京ビッグサイト 南1～4ホール
（東京都江東区有明3-11-1）

ウェブサイト：<https://www.smartbuilding.jp/ja-jp.html>

当社出展ブース：小間番号 17-22



出展製品概要

- 「ハットトッテ™」は、貼るだけで簡単に設置ができ、またはがすことで移設も簡単に行うことができる、配線不要の無線センサーです。温度・湿度・照度のセンシングを行います。
- 約5.8mmの薄さと、約38gという軽さを実現し、柔らかいボディを備えています。そのため、万一、落下して踏んでも破片が飛び散ることがなく、安全性に優れています。設置場所の壁や柱に合わせたにカラーリングも可能であり、意匠性も兼備しています。
- 無線通信方式にはLoRaWAN®*1を採用し、見通し距離にして屋内で数百メートル、屋外で数キロメートルの通信が可能です。



「ハットトッテ™」のやわらかいボディの触感、薄さ、軽さは、実物でなければ体感できません。是非、当社ブースへお越しいただき、直接ご確認ください。

【報道機関からのお問い合わせ】 コーポレートコミュニケーション部 03-6733-3033 dic-press@ma.dic.co.jp

【お客様からのお問い合わせ】 新事業統括本部エレクトロニクスビジネスユニット 03-6733-5917

なお、展示ブースでは「ハットトッテ™」のみならず、共同出展社 4 社による本製品を使用した各社のシステムの展示も行います。

共同出展社（50 音順）



株式会社 ウフル



向洋電機株式会社



株式会社 Sohwa & Sophia Technologies



HOYA デジタルソリューションズ株式会社

※1 LoRaWAN®は、LoRa Alliance®の登録商標です。LoRaWAN®は、低消費電力と広い通信範囲を特徴とする無線通信方式の一つです。

以 上

【関連ニュースリリース】

- イオン藤井寺 SC でやわらかい無線センサーの IoT 実証実験開始（2019 年 11 月 20 日）
<https://www.dic-global.com/ja/news/2019/products/20191217120211.html>
- 柔らかいエレクトロニクスを実現した、無線タイプのセンサーを開発（2019 年 2 月 1 日）
http://www.dic-global.com/ja/release/2019/20190201_01.html